

評価報告書の構成について (案)

1. 評価報告書の目次

下記目次 (案) の第 1 章を委員会でまとめる。

目次 (案)

はじめに
評価委員会分科会名簿
評価委員会分科会審議経過
評価概要
研究評価委員会におけるコメント
研究評価委員会名簿
第1章 評価
1. プロジェクト全体に関する評価結果
1.1 総論
(1) 総合評価
(2) 今後に対する提言
1.2 各論
(1) 事業の位置付け・必要性について
(2) 研究開発マネジメントについて
(3) 研究開発成果について
(4) 実用化、事業化の見通しについて
2. 個別テーマに関する評価結果
2.1 ロジック集積回路内1次メモリを対象とした、高集積・高速特性・高書き換え耐性などの機能を有する超低電圧・不揮発デバイスの開発 ・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」および「今後に対する提言」について
2.2 外部記憶の高速低電力データ転送を実現する、高集積・高速低電力書き込み特性などの機能を有する超低電圧・不揮発デバイスの開発 ・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」および「今後に対する提言」について
2.3 配線切り換えを可能とするスイッチを対象とした、低電流・高速書き換え、高オン・オフ抵抗比、小面積などの機能を有する超低電圧・不揮発スイッチデバイスの開発 ・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」および「今後に対する提言」について
2.4 集積回路チップ内において、機能ブロックの三次元集積を実現するための、微細幅・超低電気抵抗、超高アスペクト比配線・材料技術の開発 ・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」および「今後に対する提言」について
2.5 CMOSトランジスタの超低電圧動作、及びリーク電流抑制を同時に実現するための、低しきい値ばらつきトランジスタを集積化するための技術開発、並びに、この技術を用いた高集積機能素子における低電圧動作実証 ・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」および「今後に対する提言」について

2.6 BEOL設計・製造基盤（プラットフォーム）開発
・「研究開発成果」および「今後に対する提言」について

3. 評点結果

第2章 評価対象プロジェクト

参考資料1 評価の実施方法

2. 第1章のまとめ方

評価項目毎に以下のように各委員のコメントを取りまとめる。

第1章の取りまとめ方の例（案）

例：I-1. 総合評価

評価者の意見を取りまとめて作成した文書。10行程度。

(肯定的意見)

○各委員の生の意見（無記名）

○

(問題点・改善すべき点)

●各委員の生の意見（無記名）

●

(その他の意見)